



2026年度 日本包装専士会包装技術セミナー 開催報告

<http://www.housou-senshikai.jp/>

2026年5月に、3年に1度の世界最大規模の包装産業展「interpack 2026」がドイツ・デュッセルドルフで開催されました。欧州包装産業界は、厳しい経済社会状況下、PPWR(包装及び包装廃棄物規制)などのコンプライアンス・規制と経済合理性をSX(サステナブルトランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)により乗り越え、包装産業の次世代の姿を示しつつあります。このたびは技術士包装物流会／日本包装専士会の両会長の挨拶に続き、共催・協賛団体の講師が現地で実際に視察され、三者三様の視点で報告／講演いただきました。

共催 技術士包装物流会・日本包装専士会
協賛 公益社団法人日本包装技術協会
後援 日本包装管理士会・日本包装コンサルタント協会

■ プログラム

演題: 日本包装技術協会主催ツアーからのトピックス

講師: (公社)日本包装技術協会 包装技術研究所 包装材料研究室長 井出 安彦氏

演題: IPPOメンバーが捉えたinterpack2026視察報告

講師: 技術士(経営工学部門)・包装専士 兼 IPPO会員 橋本香奈氏(缶詰技術研究会)

*IPPO…International Packaging Press Organisation (国際包装プレス協会)

演題: サステナビリティ視点から見たinterpack2026視察報告

講師: 包装専士 島田 賢一(三菱商事パッケージング株式会社)

■ 開催概要

日時: 2026年8月3日(月) 15:00～17:40(講演、質疑応答含む) 17:45～18:30(交流会)

場所: 三菱商事パッケージング(株) セミナールーム(東京都中央区日本橋2-3-10)

出席: 90名(配信参加者23名含む)

■ 交流会

講演終了後、60名の交流会参加があり、講演内容や昨今の包装を取り巻く環境・課題などに関する質問や意見交換が活発に行われました。

